

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	民生加银基金、巴沃资本、前海人寿保险、浙商证券、长信基金、广东正圆私募基金、宁泉资产、亥鼎云天私募基金、加拿大鲍尔公司、名禹资产、华宝基金、国金证券、UBS、长江证券、长城证券、国联民生、侏罗纪资产、天弘基金、太平洋资产管理有限责任公司、中信资管、东方基金、禹田资产、兴业证券、人保资产、利位投资、慧琛私募、西部利得基金、、鑫元基金、中银基金、中金汇理、汇丰晋信基金、国信证券、万家基金、彝川资本、中金公司、全天候私募、东吴基金、盘京投资、上银基金、仁桥资产、光大资管、大成基金、江苏瑞华投资控股集团有限公司、中金资管、华安基金、上海东方资管、光大保德信基金、昆仑健康保险、华泰资管、兴业基金、华宝证券、中海基金、中泰证券、中邮证券、上海人寿、禾永投资
时间	2025年4月29日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士

投资者关系活动主要内容介绍

一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士介绍公司2024年年度及2025第一季度业绩与经营情况

(一) 财务状况

2024年，公司实现营业收入10.77亿元，同比增长46%；归母净利润1.28亿元，同比增长8.67%；扣非净利润1.08亿元，同比增长18.89%，第四季度单季营收3.36亿元，创单季度历史新高。2025年一季度营收2.85亿，同比增长55%；归母净利润2,591.82万元，同比扭亏为盈，扣非净利润1,417.55万元，比上年增加1,830.07万元。若剔除2024年5,472.55万元股份支付费用影响，2024年归母净利润达1.83亿。

2024年研发费用为1.42亿元，同比增长37.16%，占营收比例略有下降，随着部分研发项目量产，未来研发投入占比会继续下降，但绝对值仍会增加；2025年一季度研发费用3,963万元，绝对金额增加，占营收比重下降约三个百分点。销售费用、管理费用保持正常增长。

(二) 业务布局与产能

从营收分类看，2024年CP晶圆测试占比63%，FT占比37%；高端产品营收占比72.46%，中端占27.54%，公司通过提升高端占比改善产品结构与毛利。

南京项目已投入使用，设备持续扩充；无锡项目主建筑去年年底封顶，预计今年下半年投入使用。目前上海、无锡现有场地已基本饱和。公司预计5-6月在上海合庆拿地后尽快开工，预计明年10月完成建设，公司整体的稼动率4月比3月略有提升，预计第二至四季度稼动率逐渐上升，整体向好。

二、投资者提问

1、一季度的毛利率环比下降的原因？

答：一季度是电子和半导体行业的传统淡季，叠加春节因素，稼动率不满；另外，公司属于重资产行业，折旧及人员成本等在淡季调节弹性不大导致一季度毛利率环比下降，但2025年一季度主营业务毛利率较去年同期提升将近8个百分点。后续随着产能利用率逐渐提升以及高端产品逐步放量会拉动毛利提升。

2、一季度的稼动率及后续的展望？

答：一季度整体稼动率约七成，比去年同期有所提升。4月份稼动率约七八成。目前中端产品产能已经饱和，次高端产品已基本满产，随着市场需求传导，预计5-6月份高端产品产能利用率将逐渐提升。

3、今年公司整体capex预计是多少？

答：2024年资本开支约14.7亿元，其中设备投入大概11亿元。今年规划设备的capex金额约十个亿左右；基建方面，无锡厂和上海大概有三个亿左右的开支。

4、公司目前购买的测试机国产化率大概有多少？

答：公司目前最主要的测试机平台爱德万、泰瑞达和台湾的致茂电子都是进口的。国产测试机占比不是特别大，模拟测试机基本上已实现国产替代。

5、下游需求分布里是否包含存储业务？

答：公司目前涉及的存储类型是NOR flash，其他存储业务未做。

6、请问高端机台的占比？

答：从数量上看，中端机台占比高一些；从价值量看，高端机台大概占到70%以上。

7、今年的增长驱动力主要会来自于哪些客户？

答：现有主要客户有自身的增量，同时新增智驾、算力相关的客户。

8、目前车规芯片测试涉及哪些芯片类型？

答：主要涉及智驾、智能座舱等车载电子相关领域。

9、今年设备采购是否会受关税影响？

	<p>答：公司主要设备平台都不受关税影响。</p> <p>10、封装厂持续整合对公司在高端客户那边的放量结构是否有影响？</p> <p>答：公司与封装厂是竞合关系。公司主要业务中CP占60%，国内封装厂CP产能较小，大部分由第三方做；FT占40%，与封装厂有一定的竞争，但公司同时是众多封装厂外包商。目前封装厂侧重点在先进封装，测试作为配套，国内封装业务扩大，测试业务规模也更大，对公司有利，整体依赖产业链向国内转移，市场做大公司份额也会扩大。</p> <p>11、今年价格是否有可能出现涨价的情况？</p> <p>答：目前价格比较稳定。</p> <p>12、公司现在产能如何？未来新产能释放的节奏如何？</p> <p>答：目前产能分布在上海总部和子公司，无锡产能已超过上海，是最大的生产基地。上海后续拿地建设投资后产能会增加，目前上海基本没有空间增加产能。产能释放主要在无锡和南京，测试产能是随着设备购置和客户订单进入量产逐步释放的，是比较平缓的曲线，只要设备到位且有需求，就会有产能释放。</p>
风险提示	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	<p>无</p>